

BMA220 传感器

德国博世传感器（Bosch Sensortec GmbH）发布了采用 2mm×2mm×0.98mm 尺寸 LGA（land grid array）封装的 3 轴 MEMS 加速度传感器“BMA220”。意法半导体（STMicroelectronics）此前刚刚发布了采用 2mm×2mm 尺寸 LGA 封装的 3 轴 MEMS 加速度传感器。各公司开发的手机用 3 轴 MEMS 加速度传感器的封装尺寸有望迅速缩小到 2mm 见方。

产品特性：

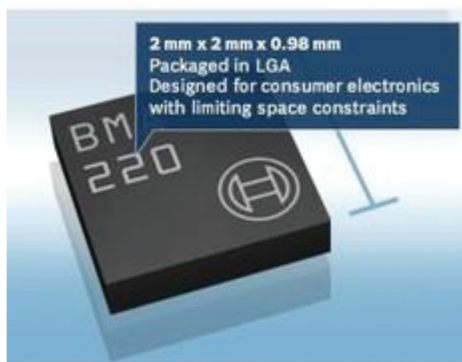
采用 2mm×2mm×0.98mm 尺寸 LGA 封装

可缩短便携产品厂商的开发周期

可延长电源的驱动时间

应用范围：

计步器、手机及游戏机控制器中等



在消费电子产品用 3 轴 MEMS 加速度传感器中，3mm×3mm 的封装尺寸此前一直是业界的竞争标准。这一标准来源于 2007 年 1 月博世传感器发布的“SMB380”。随后，ST、美国 Kionix、美国模拟器件以及美国飞思卡尔半导体纷

纷上市了采用 3mm×3mm 封装的 3 轴 MEMS 加速度传感器，而且各公司采用的封装尺寸均为 3mm×3mm。

BMA220 的检测范围可在 $\pm 2g \sim \pm 16g$ 的四个范围内设定。该产品备有用于计步器的算法，可缩短便携产品厂商的开发周期。除了计步器之外，该产品还可用于手机及游戏机控制器中的动作检测及位置检测，以及通过敲击两次手机停止来电铃声等。

博世传感器还表示，终端配备 BMA220 之后，可减少对主机端微控制器的呼叫次数。因此，可延长电源的驱动时间。

BMA220 可在传感器内置的 LSI 上运行动作识别算法。因此，传感器能够识别任意动作、空间内的位置改变、敲击一次或两次机壳的动作以及动作的快慢。另外，还可作为传感器的中断信号输出检测到的动作，同时以数字形式输出加速度数据。